ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

HSIO technologies

QFN35

Панельки испытания с шагом 0,35 мм+ обеспечивают быстрое, экономически эффективное и надежное испытание и проверку высокочастотных компонентов

Компания HSIO Technologies разработала семейство высококачественных тестовых площадок QFN35 взамен дорогостоящих панелек аналогичного класса. Что касается затрат, связанных с панельками типа ATE, то эти недорогие, высококачественные, компактные панельки испытания обеспечивают стабильную надежность сигнала на посадочном месте и в термошкафе. Каждый тестовая площадка QFN35 разработана таким образом, чтобы обеспечить успешное выполнение следующих задач:

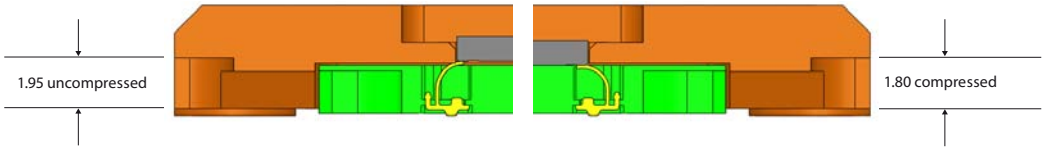
- Инженерная разработка и определение характеристик
- Испытание на принудительный отказ
- Маркетинг и оценка монтажных схем

ПРЕИМУЩЕСТВА

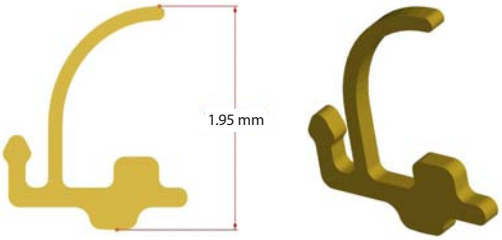
Надежность сигнала	Короткий путь прохождения сигнала способствует снижению коэффициента индукции, обеспечивая превосходную электрическую характеристику.
Снижение индукции заземления	Многофункциональные заземляющие контакты снижают индукцию заземления и обеспечивает теплопередачу через печатную плату. Возможно использование жесткого заземляющего блока для дальнейшей модернизации изделия.
Механическая прочность	Разрушение оксидной пленки при протирке защищает контакты от образования налета припоя и обеспечивает стабильное сопротивление перехода в паре “контактная поверхность – вывод” на протяжении тысяч циклов сопряжения, а также необходимую термостойкость в случае резкого повышения температуры
Взаимозаменяемость контактных групп	Использование площадок с взаимозаменяемыми группами контактов значительно снижает затраты по сравнению с покупкой нового разъема.
Высокая эффективность по времени	Размещение пассивного компонента возле устройства, интегрированного в стандартный корпус разъема, обеспечивает превосходные электрические характеристики при использовании стандартных конструкций и более короткие сроки подготовительных процессов при производстве.
Универсальность и экономическая эффективность	Испытательные панельки QFN35 спроектированы таким образом, чтобы обеспечить конечным пользователям высокую эффективность на стадии разработки, устранения неполадок, а также тестирования.

МЕТОДОЛОГИЯ

Высота контакта



КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнальная характеристика	Контакты с уменьшенными размерами обеспечивают более короткий путь прохождения сигнала.
Срезающее-протирочное действие по окислу	Контакт QFN35 протирает контактную площадь устройства, стирая окисную пленку припоя.
Контактные группы	Возможность легкой замены контактных групп при эксплуатации.
Разъединение вблизи устройства	Мелкие шаги сетки наряду с крупными гнездами разрыва, спроектированные для корпусов стандартных размеров, позволяют размещать пассивные компоненты вблизи устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ	Шаг 0.5 мм
Время задержки	13.5 пс
Собственная индуктивность	0.85 нГ
Взаимная индуктивность	0.3 нГ
Ёмкость при заземлении	0.18 пФ
Взаимная ёмкость	0.03 пФ
S_{21} Вносимые потери/Ширина полосы (Земля-Сигнал-Земля)	-1дБ @ 19.3 ГГц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сила тока	2.5 А
Контактное сопротивление	<25 миллиом
Срок службы контакта	10 000 циклов сопряжения
Нормальное усилие	30-40 грамм/контакт
Вертикальное сжатие	0.15 мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

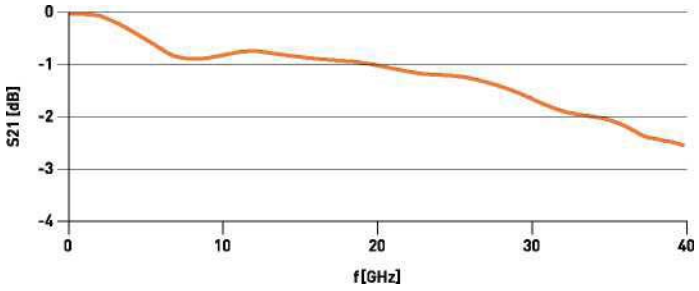
Материал изготовления контакта и покрытие	Медный сплав (Cu) Золото (Au) поверх никеля (Ni)
Высота контакта	1.95 мм
Корпус	Полиимид (Cirlex®)
Каркас	Torlon® 5030, Ultem® 2300 и\или LCP
Условия эксплуатации	-40°C - 150°C (-40°F - 302°F)

Технические параметры могут отличаться в зависимости от приложения и требований о соответствии. По запросу возможно предоставление дополнительной информации.

Технические характеристики панели

Обладая шагом сетки 0.35 мм+, тестовый площадки QFN35 разработаны для JEDEC STD. MO-220 и доступны для всех стандартных устройств в диапазоне размеров от 3 мм до 12 мм. Возможно также изготовление по чертежам заказчика. Тестовые площадки QFN35 отличаются выводами специальной конструкции, которые обеспечивают высокую точность передачи электронного сигнала в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному аналоговому, цифровому, радиочастотному Bluetooth и телекоммуникационному оборудованию. Кроме того, каждая из этих тестовых площадок спроектирована таким образом, чтобы минимизировать дорогостоящую полезную площадь печатной платы, обеспечивая предельно близкое размещение развязывающего компонента. Наряду со стандартными крышками (шарнирными или зажимными) возможно их изготовление по индивидуальному заказу. Для подбора площадок к Вашему оборудованию, воспользуйтесь услугами наших специалистов.

Вносимые потери



©Copyright2012.
HSIO Technologies,LLC/ All right reserved/ Data subject to change without notice HSIO Technologies, LLC/13300 67th Avenue North, Maple Grove, MN 55311 USA. +1.763.447.6260/ Sales@HSIOTech.com/ www.HSIOTech.com

ЗАО «ЭлекТрейд-М»
Россия, 115404, г.Москва,
11-я Радиальная ул., д.2,офис 20
Тел./Факс: +7.499.218.2360 /
info@eltm.ru / www.eltm.ru